

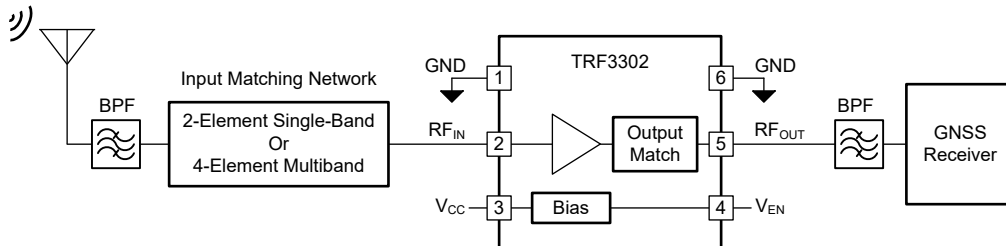
TRF3302 1165MHz 至 1630MHz、多频段、GPS 及 GNSS、低噪声放大器

1 特性

- GNSS L1 (GPS)、E1 和 B1 频段：
 - 噪声系数 (NF)：0.85dB
 - 输入回波损耗 (S11)：-11.7dB
 - 输出回波损耗 (S22)：-15.3dB
 - 2 元件输入匹配
- 多频段 GPS/GNSS L1、L2 及 L5 支持：
 - 噪声系数 (NF)：1.2dB
 - 输入回波损耗 (S11)：-12dB
 - 输出回波损耗 (S22)：-12.3dB
 - 4 元件输入匹配
- 功率增益 (G_P)：16.9dB
- 输入 IP3 (V_{CC} = 2.5V)：
 - 带内 = -5.4dBm
 - 带外 = -4.8dBm
- 输入 P1dB：-10.2dBm (V_{CC} = 2.5V)
- 集成的 50 Ω 输出匹配
- 电源电流：4.6mA (10nA 关断)
- 灵活的电源电压：1.8V 至 3.3V
- 工作结温：-40°C 至 +125°C
- 兼容自动光学检测 (AOI) 的封装：具有可润湿侧翼的 WSON-FCRLF-6 封装
- 可用汽车 AEC-Q100 型号：TRF3302-Q1

2 应用

- GNSS 接收器 LNA
- 全球定位接收器
- 资产跟踪器
- 智能追踪器
- 远程信息处理控制单元 (TCU)
- 智能天线模块
- 自动紧急呼叫 (eCall)
- 电子收费 (ETC)
- 导航及全球定位系统



典型的 GNSS 接收器系统

3 说明

TRF3302 是一款专门为 GNSS 接收器应用而设计的高增益、低噪声放大器 (LNA)。此器件具有 16.9dB 的功率增益，具有 0.85dB 的超低噪声系数，适用于高灵敏度 GNSS 接收器。输入参考 P1dB 为 -10.2dBm、IP3 为 -5.4dBm，有助于在存在蜂窝频段干扰信号的情况下保持接收器灵敏度。

TRF3302 的宽带设计支持 GNSS 卫星星座中的各种频段，如 GPS、Galileo、BeiDou、QZSS、NavIC/IRNSS 和 GLONASS。此器件还支持铱卫星系统的 L 波段。2 元件 (电容器和电感器) 输入匹配可为 L1 (GPS)、E1 (Galileo) 及 B1 (BeiDou) 频段提供低噪声和良好的回波损耗性能。对于需要覆盖较低 GPS 频段 L2 至 L5、Galileo E6 至 E5a、BeiDou B3 至 B2a、QZSS L6、NavIC L5 和 GLONASS 频段 G2 至 G3 的应用，电感器值可进行调节，以实现接近 150MHz 的带宽，同时将性能下降至最低。4 元件外部输入匹配网络与 TRF3302 的宽带输出相结合，可为所有主要 GNSS 频段提供性能覆盖，且 $\approx 1.2\text{dB}$ NF，S11 和 S22 优于 -10dB。

TRF3302 由 1.8V 至 3.3V 单电源供电，在功耗和热敏感型设计中仅消耗 4.6mA 电流。该器件具有一个数字逻辑兼容使能引脚，可进一步节省功耗。TRF3302 额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
TRF3302	具有可湿性侧翼的 VBL (WSON-FCRLF, 6)	1.3mm × 1mm

(1) 有关更多信息，请参阅节 10。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。



内容

1 特性.....	1	6.3 特性说明.....	16
2 应用.....	1	6.4 器件功能模式.....	16
3 说明.....	1	7 应用和实施.....	17
4 引脚配置和功能.....	2	7.1 应用信息.....	17
5 规格.....	3	7.2 典型应用.....	17
5.1 绝对最大额定值.....	3	7.3 电源相关建议.....	19
5.2 ESD 等级.....	3	7.4 布局.....	19
5.3 建议运行条件.....	3	8 器件和文档支持.....	20
5.4 热性能信息.....	3	8.1 接收文档更新通知.....	20
5.5 电气特性 - GPS L1 频段.....	4	8.2 支持资源.....	20
5.6 电气特性 - GPS L5 和 L2 频段.....	5	8.3 商标.....	20
5.7 典型特性 - GPS L1 频段.....	6	8.4 静电放电警告.....	20
5.8 典型特征 - GPS L5 和 L2 频段.....	11	8.5 术语表.....	20
6 详细说明.....	15	9 修订历史记录.....	20
6.1 概述.....	15	10 机械、封装和可订购信息.....	20
6.2 功能方框图.....	15		

4 引脚配置和功能

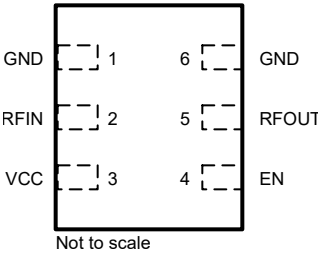


图 4-1. VBL 封装，6 引脚 WSON-FCRLF (顶视图)

表 4-1. 引脚功能

引脚		类型	说明
编号	名称		
1	GND	接地	射频与直流感地。连接至 PCB 接地平面。
2	RFIN	输入	RF 输入。可选外部直流阻断电容器。内部与 50 Ω 匹配。
3	VCC	电源	电源。
4	EN	输入	器件使能信号，以接地为基准。强制输出电压。 逻辑 1 = 启用。 逻辑 0 = 断电。
5	RFOUT	输出	RF 输出。集成直流阻断电容器，并在内部与 50 Ω 匹配。
6	GND	接地	射频与直流感地。连接至 PCB 接地平面。

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) ⁽¹⁾

			最小值	最大值	单位
V _{CC}	电源电压 ⁽²⁾			3.45	V
RF _{IN} 、RF _{OUT}	RF 引脚上的电压 ⁽²⁾	V _{CC} ≤ 2.05V, 无射频	-1.4V	V _{CC} + 1.4V	V
		V _{CC} > 2.05V, 无射频	-1.4V	3.45V	
P _{IN}	输入射频功率			10	dBm
V _{EN}	使能引脚电压 ⁽²⁾	V _{CC} ≤ 2.75V	-0.7V	V _{CC} + 0.7V	V
		V _{CC} > 2.75V	-0.7V	3.45V	
T _J	结温		-40	150	°C
T _{stg}	贮存温度		-55	150	°C

(1) 超出绝对最大额定值规定范围的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些仅为应力额定值, 并不意味着器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

(2) 以 GND 为参考。

5.2 ESD 等级

			值	单位
V _(ESD)	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准, 所有引脚 ⁽¹⁾	±1750	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 JEDEC 规范 JS-002, 所有引脚 ⁽²⁾	±1500	

(1) JEDEC 文档 JEP155 指出: 500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

(2) JEDEC 文档 JEP157 指出: 250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

		最小值	标称值	最大值	单位
V _{CC}	电源电压	1.75		3.3	V
T _J	结温	-40		125	°C

5.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		TRF3302	单位
		VBL (WSON-FCRLF)	
		6 引脚	
R _{θJA}	结至环境热阻	152.1	°C/W
R _{θJC(top)}	结至外壳 (顶部) 热阻	78.5	°C/W
R _{θJB}	结至电路板热阻	44.2	°C/W
Ψ _{JT}	结至顶部特征参数	2.9	°C/W
Ψ _{JB}	结至电路板特征参数	44.1	°C/W
R _{θJC(bot)}	结至外壳 (底部) 热阻	不适用	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅 [半导体和 IC 封装热指标](#) 应用报告。

5.5 电气特性 - GPS L1 频段

条件为 $T_A = 27^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 2.5\text{V}$, $f = 1575\text{MHz}$ (L1 频段), 电源阻抗 (Z_S) = 负载阻抗 (Z_L) = 50Ω , 并且输入匹配 50Ω , 其中 $L1 = 8.2\text{nH}$ (0402DC-8N2XGRW) 且 $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01), 具有图 6-2 中所示输入和输出配置, 输入端的电容器 $C1$ 和输出端的 RFOUT 引脚已去嵌入 (除非另有说明)

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
射频性能							
	工作频率			1300	1575	1630	MHz
G _P	小信号功率增益	P _{IN} = - 27dBm	V _{CC} = 1.8V	12.3	16.9	19.5	dB
			V _{CC} = 2.5V	12.8	16.8	19.7	
			V _{CC} = 3.3V	12.8	16.8	20.7	
NF	噪声系数	V _{CC} = 1.8V 至 3.3V		0.85			dB
S ₁₁	输入回波损耗	P _{IN} = - 27dBm、V _{CC} = 1.8V to 3.3V		-11.7			dB
S ₂₂	输出回波损耗	P _{IN} = - 27dBm、V _{CC} = 1.8V to 3.3V		-15.3			dB
S ₁₂	反向隔离	P _{IN} = - 27dBm、V _{CC} = 1.8V to 3.3V		-42.5			dB
IP1dB	输入 1dB 压缩点	无干扰器	V _{CC} = 1.8V	-13.2			dBm
			V _{CC} = 2V	-11.7			
			V _{CC} = 2.5V	-14.7	-10.2		
			V _{CC} > 2.5V	-10.2			
	输入 1dB 压缩点	f _{JAM} = 850MHz，P _{JAM} = - 20dBm	V _{CC} = 1.8V	-14.4			dBm
			V _{CC} ≥ 2.5V	-10.7			
	输入 1dB 压缩点	f _{JAM} = 1850MHz，P _{JAM} = - 20dBm	V _{CC} = 1.8V	-13.8			dBm
			V _{CC} ≥ 2.5V	-10.8			
IIP3	带内输入三阶截点	P _{IN} = - 25dBm/子载波、5MHz 子载波间隔	V _{CC} = 1.8V	-5.5			dBm
			V _{CC} ≥ 2V	-5.4			
IIP3 _{OOB}	带外输入三阶截点	P _{IN} = - 25dBm/子载波，f = 1575MHz，带外 f ₁ = 1713MHz 且 f ₂ = 1851MHz	V _{CC} = 1.8V	-5.7			dBm
			V _{CC} = 2V	-5.2			
			V _{CC} ≥ 2.2V	-4.8			
K	Rollett 稳定性系数			1			
直流参数							
V _{CC}	电源电压			1.8		3.3	V
I _{CC}	有效电源电流	V _{CC} = 1.8V，无射频		3	4.6	5.9	mA
		V _{CC} = 2.5V，无射频		3.2	4.6	5.9	mA
		V _{CC} = 3.3V，无射频		3.2	4.6	7	mA
	有功功率损耗	V _{CC} = 1.8V，无射频			8.3	10.6	mW
		V _{CC} = 2.5V，无射频			11.5	14.8	
		V _{CC} = 3.3V，无射频			15.2	23.1	
I _{SHDN}	关断电源电流	V _{CC} = 1.8V，无射频			0.01	1	μA
		V _{CC} = 2.5V，无射频			0.01	1	
		V _{CC} = 3.3V，无射频			0.05		
t _{ON}	导通时间	50% EN 控制至 90% P _O		1.4			μs
t _{OFF}	关断时间	50% EN 控制至 10% P _O		0.4			μs
断电控制级别							
V _{IH}	高电平输入电压	逻辑 1，V _{CC} = 1.8V 至 3.3V		1.5			V
V _{IL}	低电平输入电压	逻辑 0，V _{CC} = 1.8V 至 3.3V				0.4	V

5.6 电气特性 - GPS L5 和 L2 频段

条件为 $T_A = 27^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 2.5\text{V}$, $f = 1176\text{MHz}$ (L5 频段), 电源阻抗 (Z_S) = 负载阻抗 (Z_L) = 50Ω , 并且输入匹配 50Ω , 其中 $L1 = 11\text{nH}$ (0402DC-11NXGRW) 且 $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01), 具有图 6-2 中所示输入和输出配置, 输入端的电容器 C1 和输出端的 RFOUT 引脚已去嵌入 (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
射频性能						
	工作频率		1165	1176	1320	MHz
G_P	小信号功率增益	$V_{CC} = 1.8\text{V}$ 至 3.3V , $P_{IN} = -27\text{dBm}$		16.5		dB
NF	噪声系数	$V_{CC} = 1.8\text{V}$ 至 3.3V		0.8		dB
S_{11}	输入回波损耗	$P_{IN} = -27\text{dBm}$ 、 $V_{CC} = 1.8\text{V}$ to 3.3V		-12.9		dB
S_{22}	输出回波损耗	$P_{IN} = -27\text{dBm}$ 、 $V_{CC} = 1.8\text{V}$ to 3.3V		-9		dB
S_{12}	反向隔离	$P_{IN} = -27\text{dBm}$ 、 $V_{CC} = 1.8\text{V}$ to 3.3V		-43.6		dB
IP1dB	输入 1dB 压缩点	无干扰器	$V_{CC} = 1.8\text{V}$	-13.4		dBm
			$V_{CC} = 2\text{V}$	-12		
			$V_{CC} \geq 2.5\text{V}$	-10.6		
IIP3	带内输入三阶截点	$P_{IN} = -25\text{dBm}$ /子载波、 5MHz 子载波间隔	$V_{CC} = 1.8\text{V}$	-6.1		dBm
			$V_{CC} \geq 2\text{V}$	-6		
K	Rollett 稳定性系数		1			

5.7 典型特性 - GPS L1 频段

条件为 $T_A = 27^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 2.5\text{V}$, $f = 1575\text{MHz}$ (L1 频段), 电源阻抗 (Z_S) = 负载阻抗 (Z_L) = 50Ω , 输入匹配 50Ω , 其中 $L1 = 8.2\text{nH}$ (0402DC-8N2XGRW) 且 $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01), 具有图 6-2 中所示输入和输出配置, 输入端的电容器 $C1$ 和输出端的 RFOUT 引脚已去嵌入, 所示环境温度 (除非另有说明)

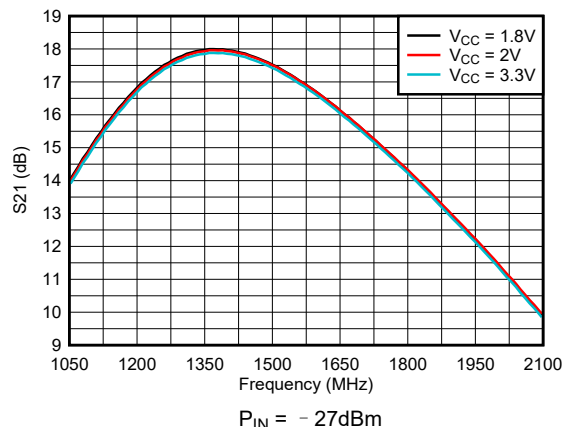


图 5-1. 整个 V_{CC} 范围内的功率增益 (S21)

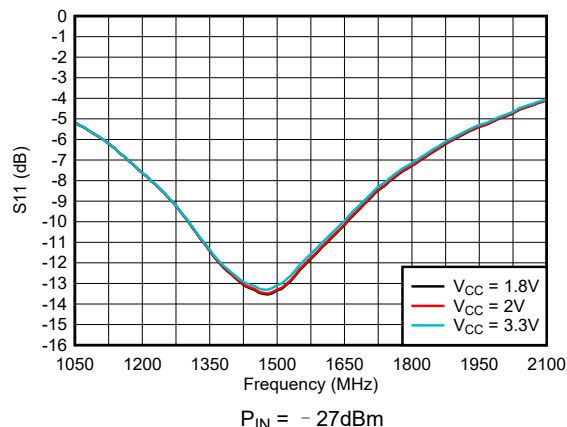


图 5-2. 整个 V_{CC} 内的输入回波损耗 (S11)

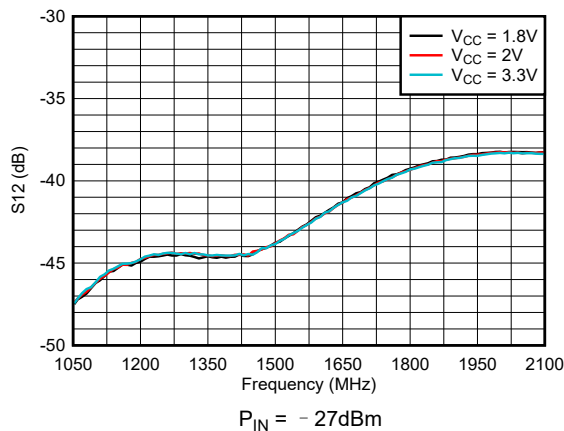


图 5-3. 整个 V_{CC} 范围内的反向隔离 (S12)

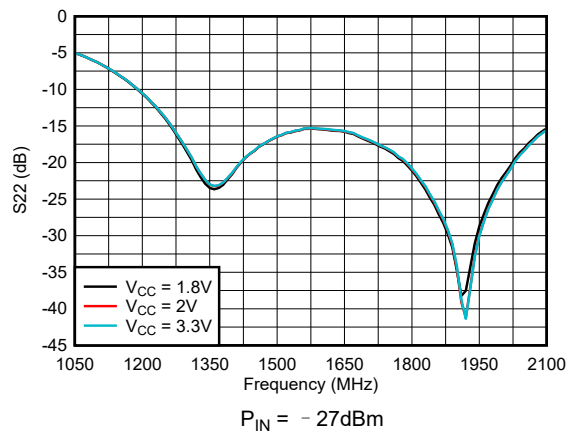


图 5-4. 整个 V_{CC} 内的输出回波损耗 (S22)

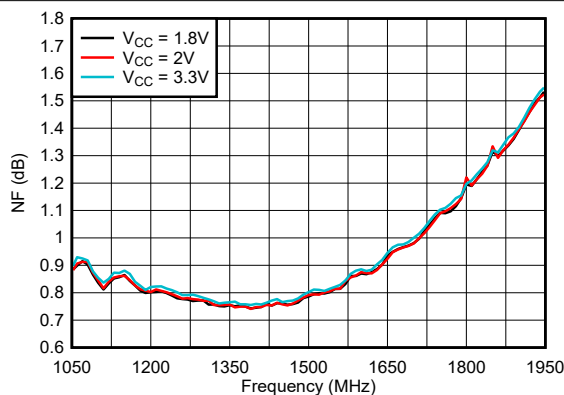


图 5-5. 整个 V_{CC} 范围内的 NF

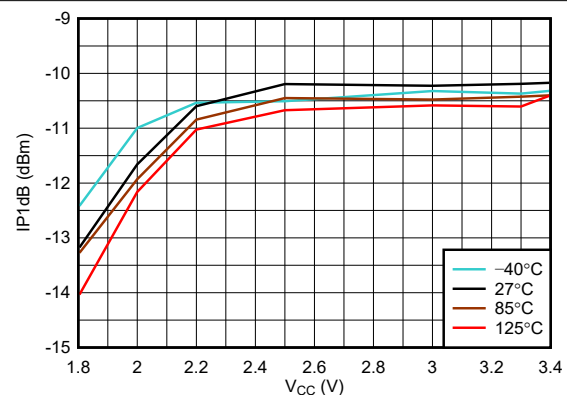


图 5-6. 整个温度范围内 IP1dB 与 V_{CC} 间的关系

5.7 典型特性 - GPS L1 频段 (续)

条件为 $T_A = 27^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 2.5\text{V}$, $f = 1575\text{MHz}$ (L1 频段), 电源阻抗 (Z_S) = 负载阻抗 (Z_L) = 50Ω , 输入匹配 50Ω , 其中 $L1 = 8.2\text{nH}$ (0402DC-8N2XGRW) 且 $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01), 具有图 6-2 中所示输入和输出配置, 输入端的电容器 $C1$ 和输出端的 RFOUT 引脚已去嵌入, 所示环境温度 (除非另有说明)

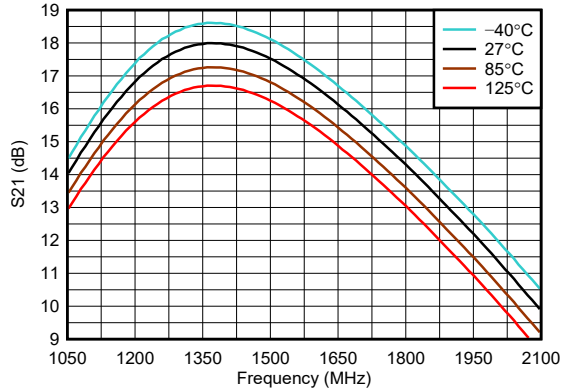


图 5-7. 整个温度范围内的功率增益 (S21)

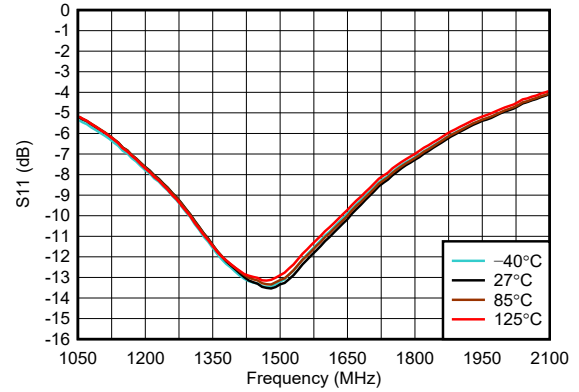


图 5-8. 整个温度范围内的输入回波损耗 (S11)

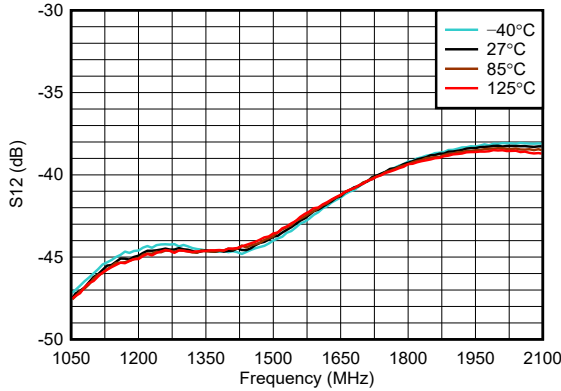


图 5-9. 整个温度范围内的反向隔离 (S12)

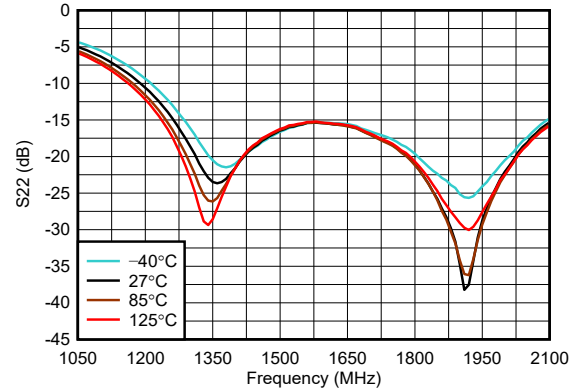


图 5-10. 整个温度范围内的输出回波损耗 (S22)

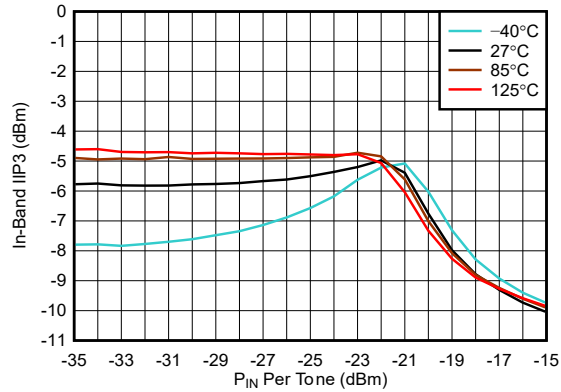


图 5-11. 整个温度范围内带内 IIP3 与输入功率 (P_{in}) 间的关系

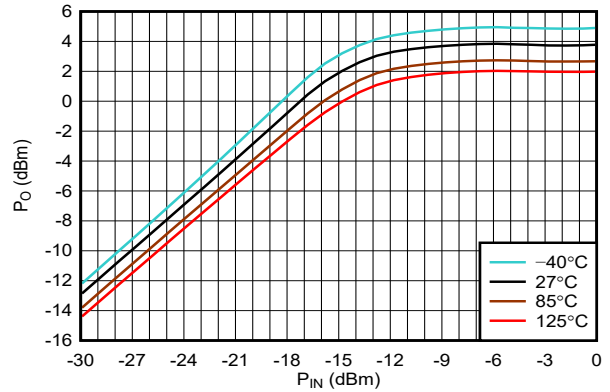


图 5-12. 整个温度范围内输出功率 (P_O) 与输入功率 (P_{IN}) 间的关系

5.7 典型特性 - GPS L1 频段 (续)

条件为 $T_A = 27^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 2.5\text{V}$, $f = 1575\text{MHz}$ (L1 频段), 电源阻抗 (Z_S) = 负载阻抗 (Z_L) = 50Ω , 输入匹配 50Ω , 其中 $L1 = 8.2\text{nH}$ (0402DC-8N2XGRW) 且 $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01), 具有图 6-2 中所示输入和输出配置, 输入端的电容器 $C1$ 和输出端的 RFOUT 引脚已去嵌入, 所示环境温度 (除非另有说明)

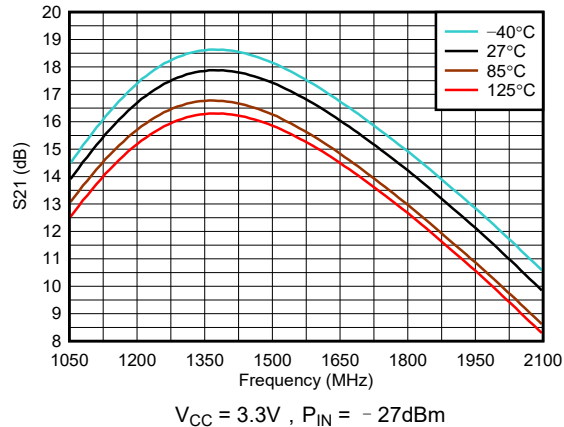


图 5-13. 整个温度范围内的功率增益 (S21)

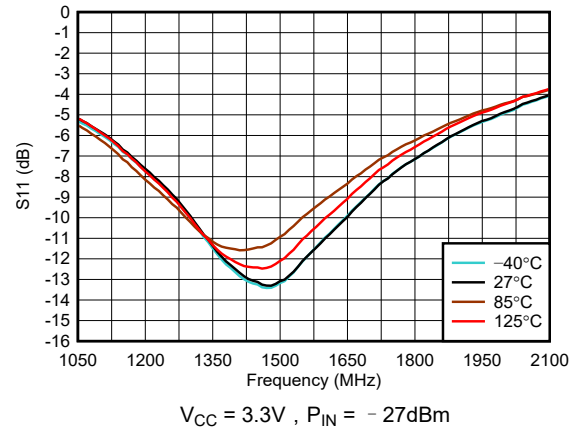


图 5-14. 整个温度范围内的输入回波损耗 (S11)

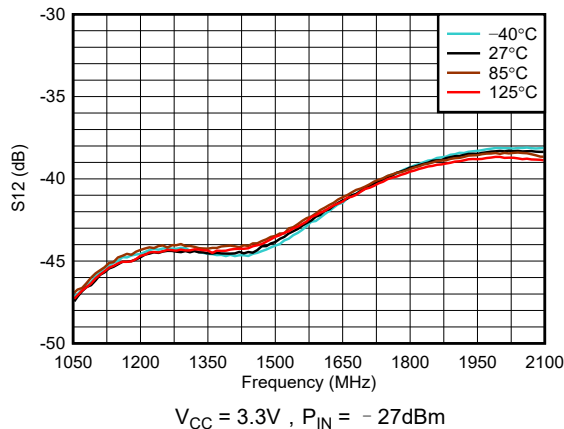


图 5-15. 整个温度范围内的反向隔离 (S12)

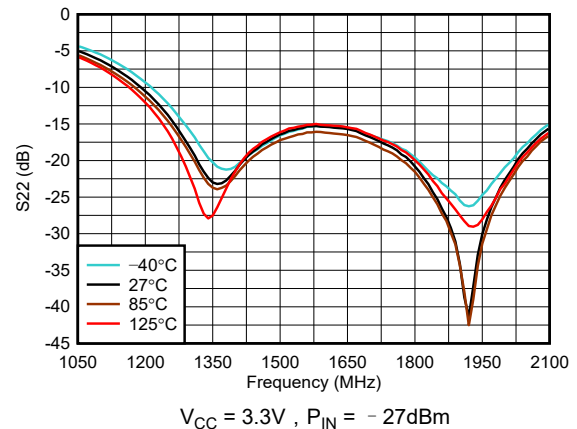
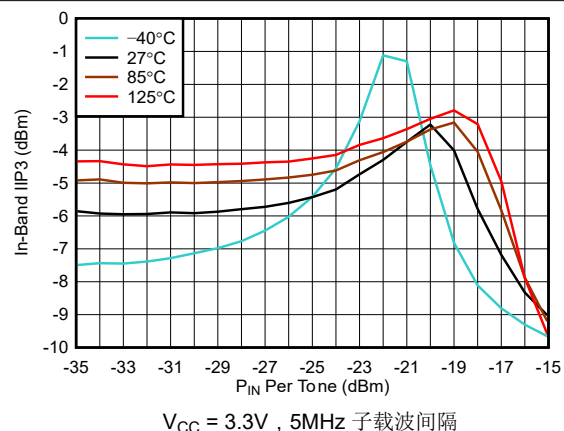
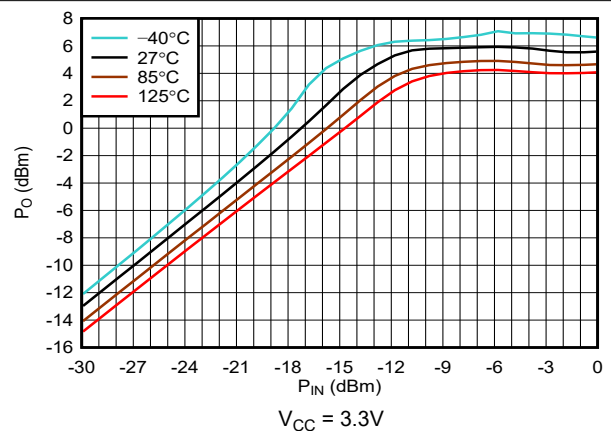


图 5-16. 整个温度范围内的输出回波损耗 (S22)

图 5-17. 整个温度范围内带内 IIP3 与输入功率 (P_{IN}) 间的关系图 5-18. 整个温度范围内输出功率 (P_O) 与输入功率 (P_{IN}) 间的关系

5.7 典型特性 - GPS L1 频段 (续)

条件为 $T_A = 27^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 2.5\text{V}$, $f = 1575\text{MHz}$ (L1 频段), 电源阻抗 (Z_S) = 负载阻抗 (Z_L) = 50Ω , 输入匹配 50Ω , 其中 $L1 = 8.2\text{nH}$ (0402DC-8N2XGRW) 且 $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01), 具有图 6-2 中所示输入和输出配置, 输入端的电容器 $C1$ 和输出端的 RFOUT 引脚已去嵌入, 所示环境温度 (除非另有说明)

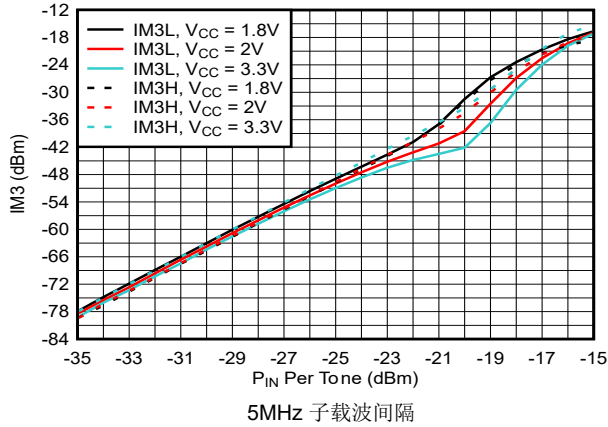


图 5-19. 整个 V_{CC} 范围内带内 IM3 与输入功率 (P_{IN}) 间的关系

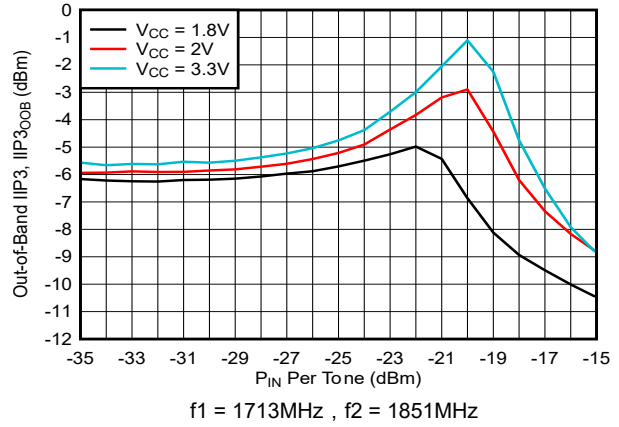


图 5-20. 整个 V_{CC} 范围内带外 IIP3 与输入功率 (P_{IN}) 间的关系

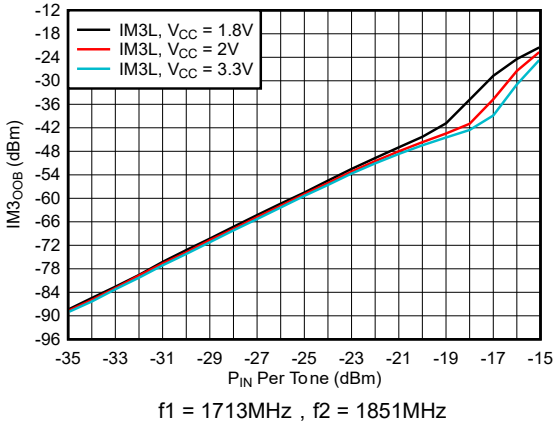


图 5-21. 整个 V_{CC} 范围内带外 IM3 与输入功率 (P_{IN}) 间的关系

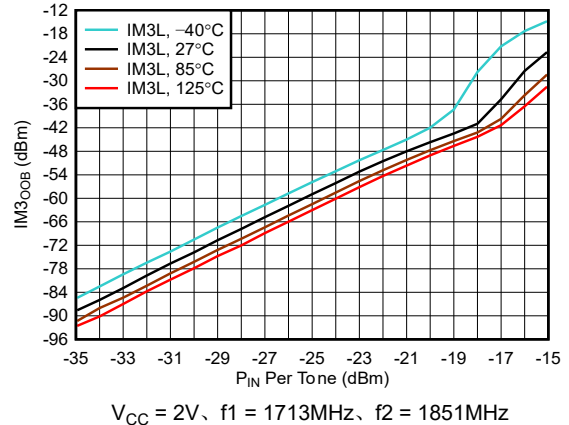


图 5-22. 整个温度范围内带外 IM3 与输入功率 (P_{IN}) 间的关系

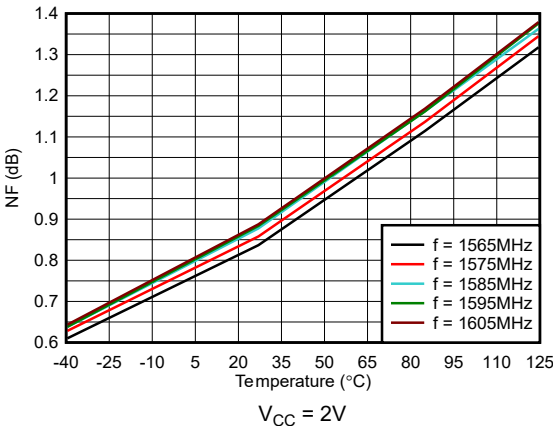


图 5-23. 整个频率范围内 NF 与温度间的关系

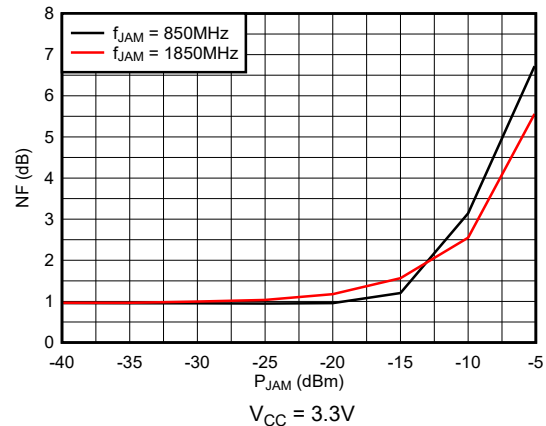


图 5-24. 整个干扰器频率范围 (f_{JAM}) 内 NF 与干扰器功率 (P_{JAM}) 间的关系

5.7 典型特性 - GPS L1 频段 (续)

条件为 $T_A = 27^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 2.5\text{V}$, $f = 1575\text{MHz}$ (L1 频段), 电源阻抗 (Z_S) = 负载阻抗 (Z_L) = 50Ω , 输入匹配 50Ω , 其中 $L1 = 8.2\text{nH}$ (0402DC-8N2XGRW) 且 $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01), 具有图 6-2 中所示输入和输出配置, 输入端的电容器 $C1$ 和输出端的 RFOUT 引脚已去嵌入, 所示环境温度 (除非另有说明)

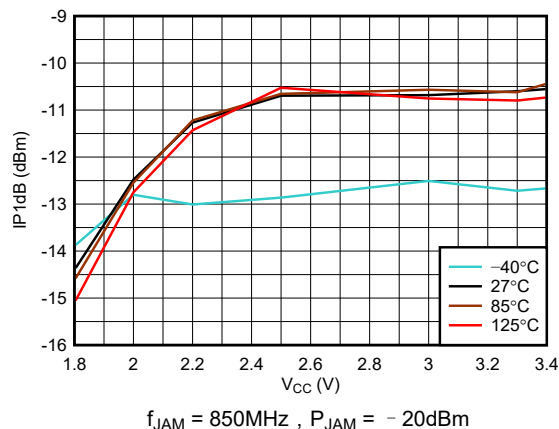


图 5-25. 有干扰器整个温度范围内 IP1dB 与 V_{CC} 间的关系

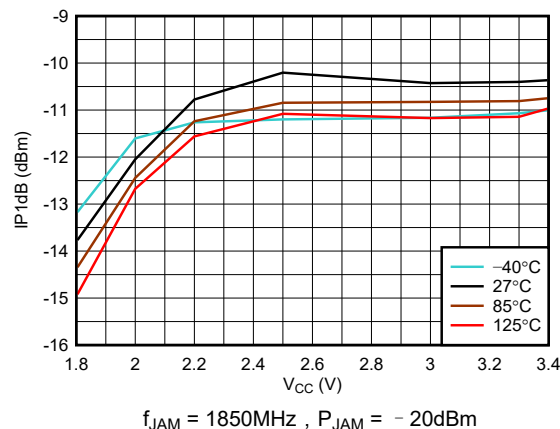


图 5-26. 有干扰器整个温度范围内 IP1dB 与 V_{CC} 间的关系

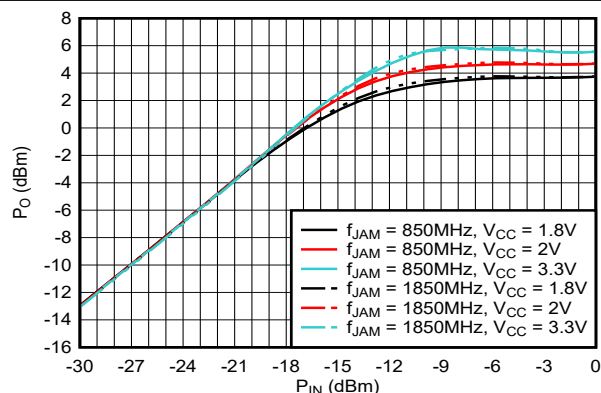


图 5-27. 整个干扰器和 V_{CC} 范围内输出功率 (P_O) 与输入功率 (P_{IN}) 间的关系

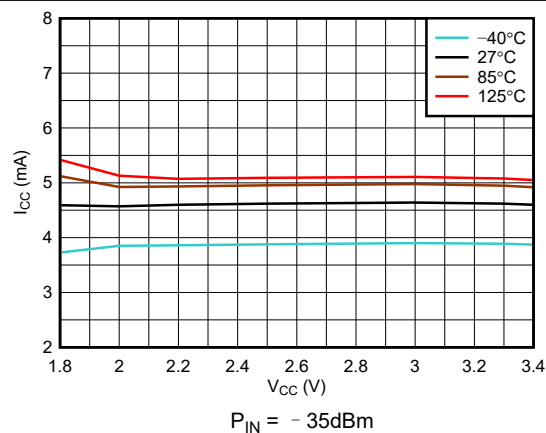


图 5-28. 整个温度范围内 I_{CC} 与 V_{CC} 间的关系

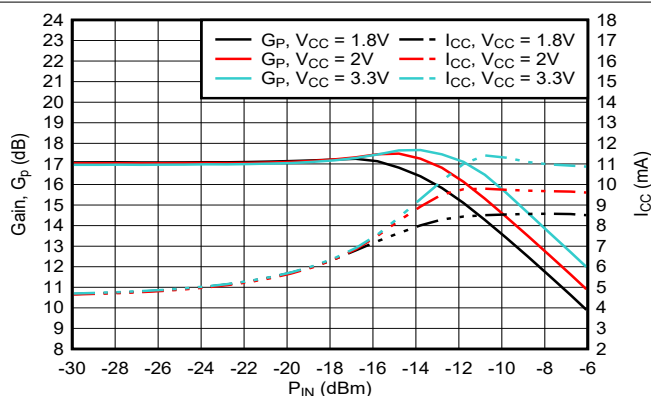


图 5-29. 整个 V_{CC} 范围内的增益和 I_{CC} 与 P_{IN} 间的关系

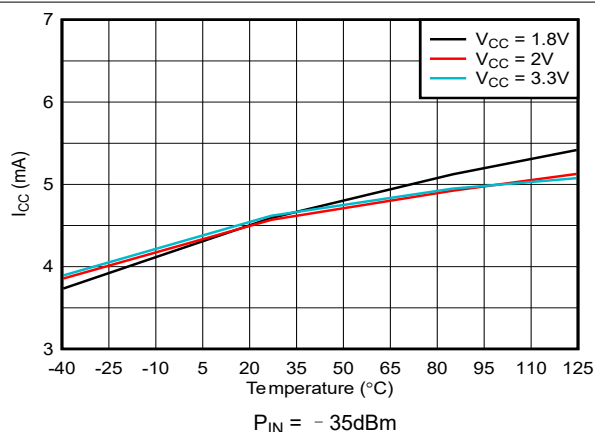


图 5-30. 整个 V_{CC} 范围内 I_{CC} 与温度间的关系

5.8 典型特征 - GPS L5 和 L2 频段

条件为 $T_A = 27^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 2.5\text{V}$, $f = 1176\text{MHz}$ (L5 频段), 电源阻抗 (Z_S) = 负载阻抗 (Z_L) = $50\ \Omega$, 输入匹配 $50\ \Omega$, 其中 $L1 = 11\text{nH}$ (0402DC-11NXGRW) 且 $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01), 具有图 6-2 中所示输入和输出配置, 输入端的电容器 $C1$ 和输出端的 RFOUT 引脚已去嵌入, 所示环境温度 (除非另有说明)

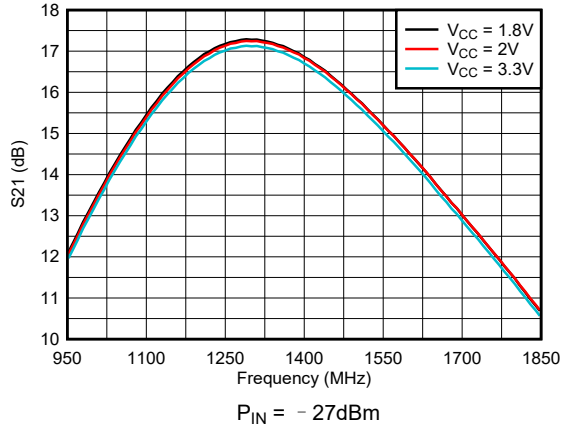


图 5-31. 整个 V_{CC} 范围内的功率增益 (S_{21})

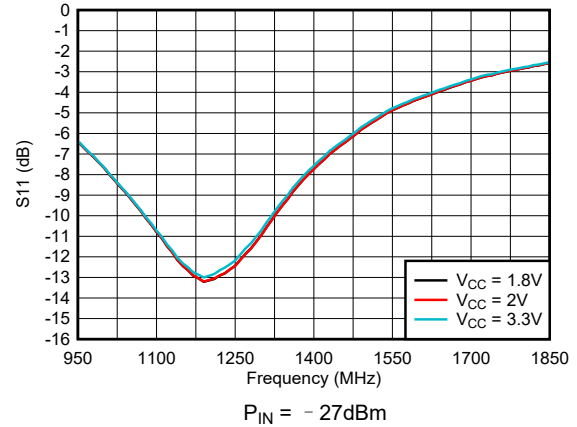


图 5-32. 整个 V_{CC} 内的输入回波损耗 (S_{11})

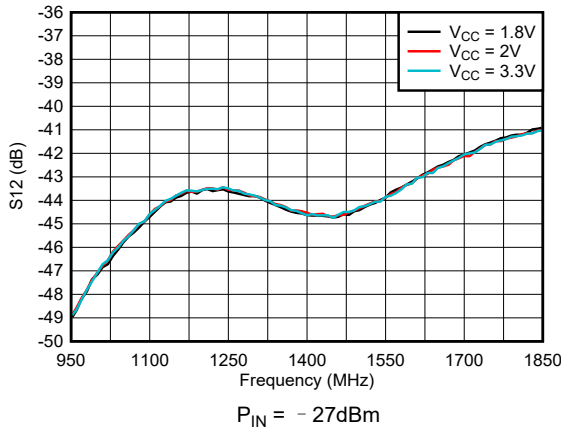


图 5-33. 整个 V_{CC} 范围内的反向隔离 (S_{12})

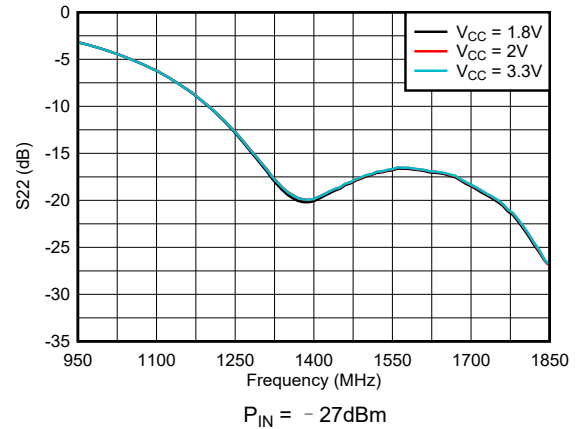


图 5-34. 整个 V_{CC} 内的输出回波损耗 (S_{22})

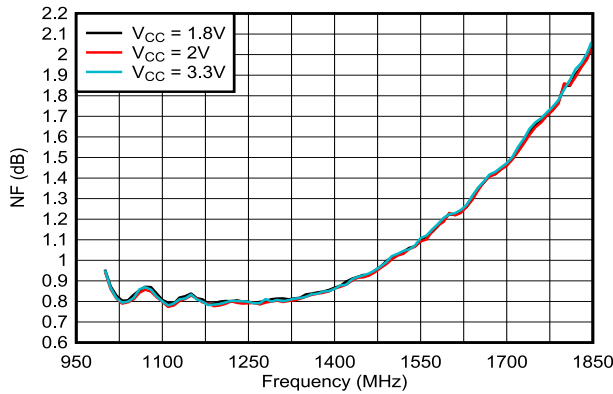


图 5-35. 整个 V_{CC} 范围内的 NF

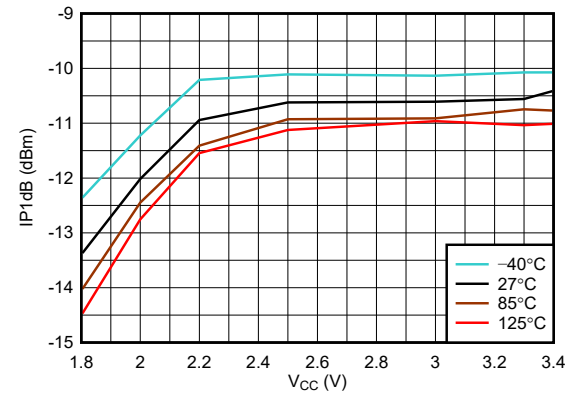


图 5-36. 整个温度范围内 $IP1\text{dB}$ 与 V_{CC} 间的关系

5.8 典型特征 - GPS L5 和 L2 频段 (续)

条件为 $T_A = 27^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 2.5\text{V}$, $f = 1176\text{MHz}$ (L5 频段), 电源阻抗 (Z_S) = 负载阻抗 (Z_L) = $50\ \Omega$, 输入匹配 $50\ \Omega$, 其中 $L1 = 11\text{nH}$ (0402DC-11NXGRW) 且 $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01), 具有图 6-2 中所示输入和输出配置, 输入端的电容器 $C1$ 和输出端的 RFOUT 引脚已去嵌入, 所示环境温度 (除非另有说明)

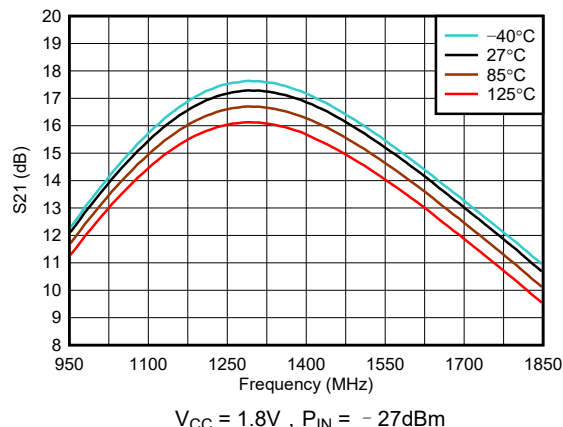


图 5-37. 整个温度范围内的功率增益 (S21)

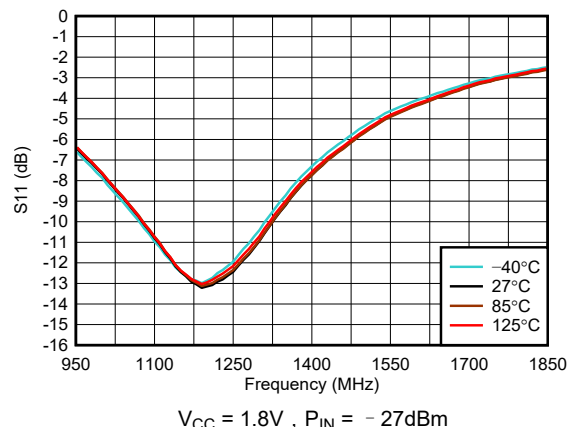


图 5-38. 整个温度范围内的输入回波损耗 (S11)

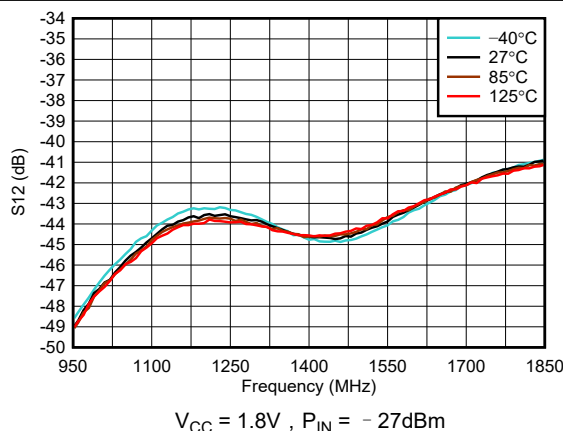


图 5-39. 整个温度范围内的反向隔离 (S12)

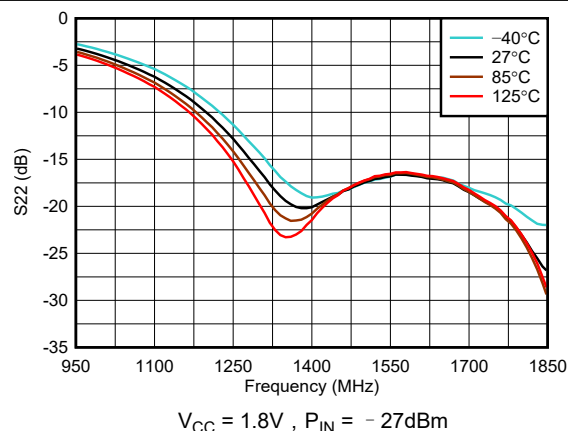
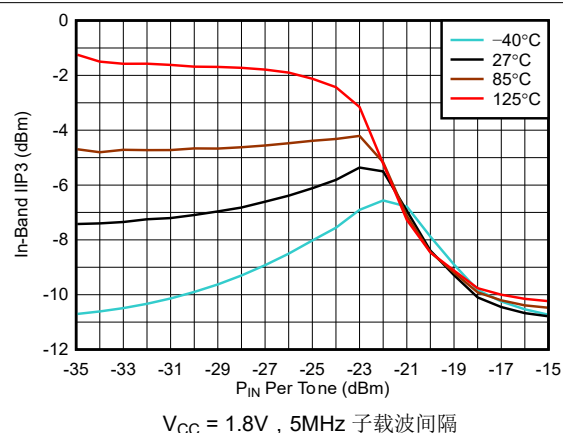
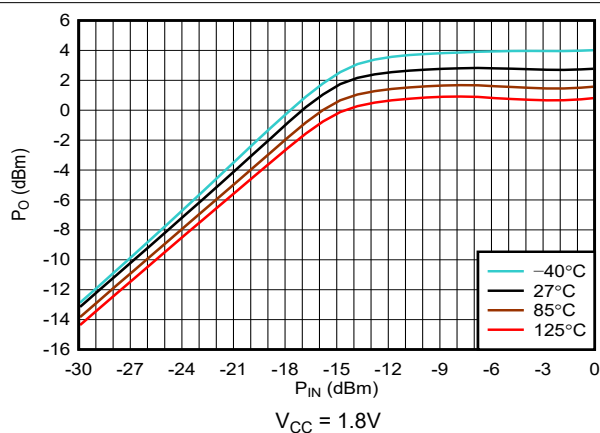


图 5-40. 整个温度范围内的输出回波损耗 (S22)

图 5-41. 整个温度范围内带内 IIP3 与输入功率 (P_{IN}) 间的关系图 5-42. 整个温度范围内输出功率 (P_O) 与输入功率 (P_{IN}) 间的关系

5.8 典型特征 - GPS L5 和 L2 频段 (续)

条件为 $T_A = 27^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 2.5\text{V}$, $f = 1176\text{MHz}$ (L5 频段), 电源阻抗 (Z_S) = 负载阻抗 (Z_L) = 50Ω , 输入匹配 50Ω , 其中 $L1 = 11\text{nH}$ (0402DC-11NXGRW) 且 $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01), 具有图 6-2 中所示输入和输出配置, 输入端的电容器 $C1$ 和输出端的 RFOUT 引脚已去嵌入, 所示环境温度 (除非另有说明)

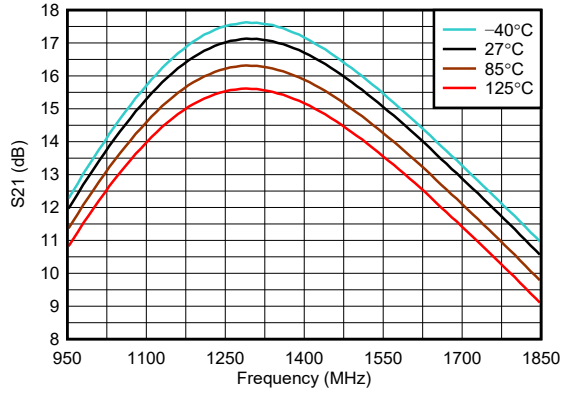


图 5-43. 整个温度范围内的功率增益 (S21)

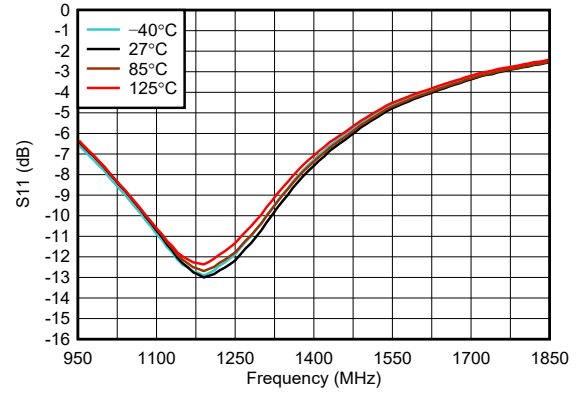


图 5-44. 整个温度范围内的输入回波损耗 (S11)

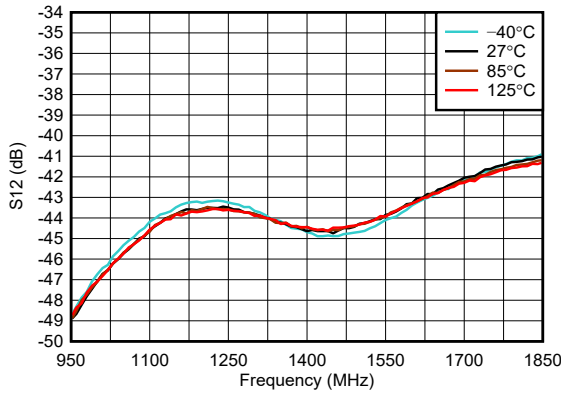


图 5-45. 整个温度范围内的反向隔离 (S12)

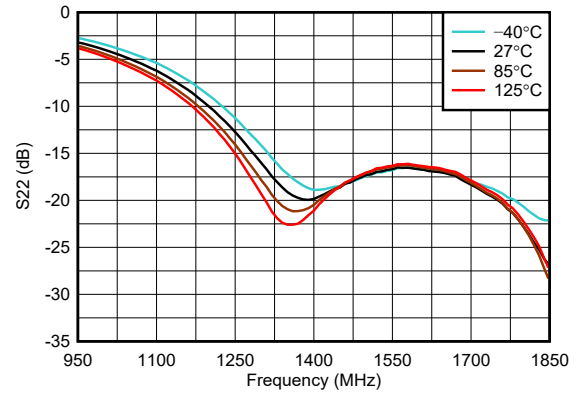


图 5-46. 整个温度范围内的输出回波损耗 (S22)

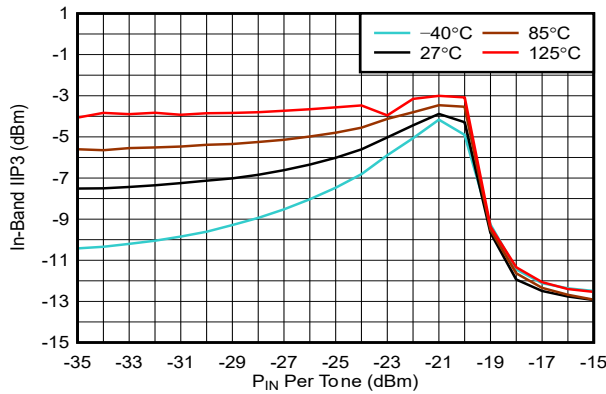


图 5-47. 整个温度范围内带内 IIP3 与输入功率 (P_{IN}) 间的关系

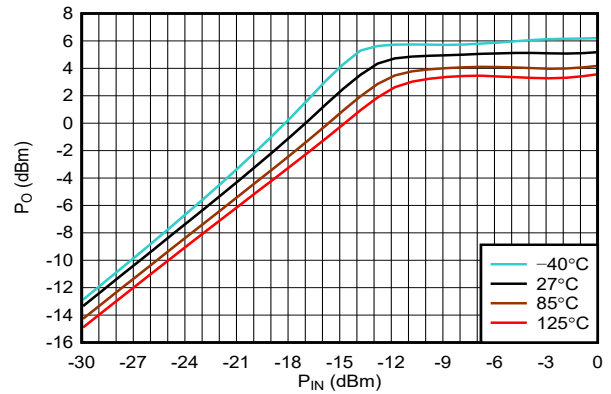


图 5-48. 整个温度范围内输出功率 (P_O) 与输入功率 (P_{IN}) 间的关系

5.8 典型特征 - GPS L5 和 L2 频段 (续)

条件为 $T_A = 27^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 2.5\text{V}$, $f = 1176\text{MHz}$ (L5 频段), 电源阻抗 (Z_S) = 负载阻抗 (Z_L) = 50Ω , 输入匹配 50Ω , 其中 $L1 = 11\text{nH}$ (0402DC-11NXGRW) 且 $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01), 具有图 6-2 中所示输入和输出配置, 输入端的电容器 $C1$ 和输出端的 RFOUT 引脚已去嵌入, 所示环境温度 (除非另有说明)

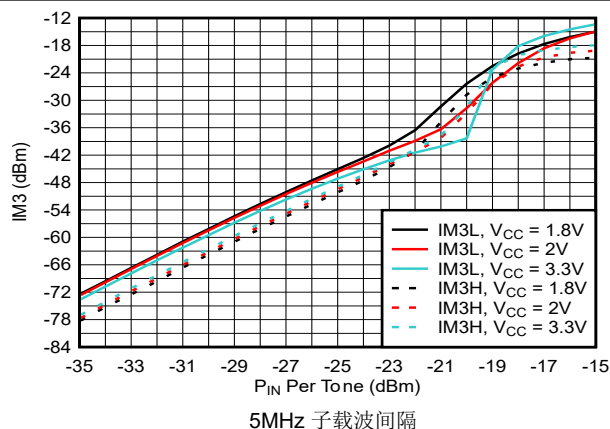


图 5-49. 整个 V_{CC} 范围内带内 IM3 与输入功率 (P_{IN}) 间的关系

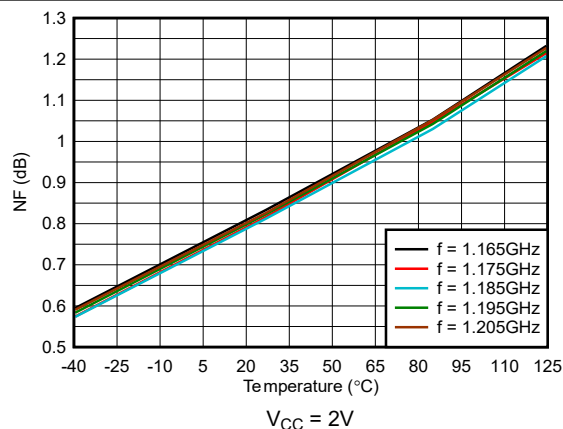


图 5-50. 整个频率范围内 NF 与温度间的关系

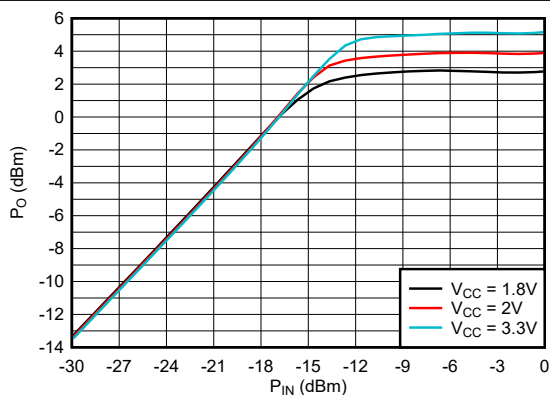


图 5-51. 整个 V_{CC} 范围内输出功率 (P_O) 与输入功率 (P_{IN}) 间的关系

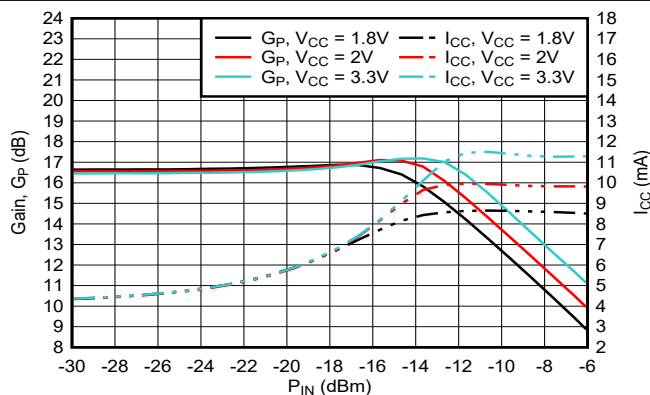


图 5-52. 整个 V_{CC} 范围内的增益和 I_{CC} 与 P_{IN} 间的关系

6 详细说明

6.1 概述

TRF3302 是一款 GNSS/GPS LNA，旨在提高 GNSS/GPS 接收器的 GNSS 信号灵敏度，并支持提供全球定位、导航和计时服务的各种卫星星座。该器件具有一个使能引脚 (EN)，用于将器件置于节能关断模式。借助此特性，无需使用外部电源断开开关或降低整个 V_{CC} 电源电压。

由 1.8V 至 3.3V 单电源供电运行，消耗 4.6mA 的典型电源电流，该器件可实现 -10.2dBm IP1dB。该器件采用节省空间的 $1.3\text{mm} \times 1\text{mm}$ 、6 针、WSON-FCRLF 封装，具有可湿侧翼。

6.2 功能方框图

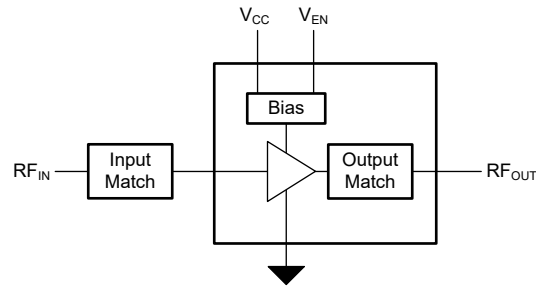


图 6-1. TRF3302 功能方框图

6.3 特性说明

TRF3302 是一款多功能 LNA，可配置为针对上限或下限 L 频段频率优化单个 GNSS 频段匹配的性能，也可配置为在从 1165MHz 到 1630MHz 的多个 GNSS 频段之间实现宽频率覆盖。

TRF3302 具有集成宽带输出匹配功能，因此无需使用外部匹配元件即可连接 GNSS 接收器，从而减少了 BOM 数量并缩小了解决方案尺寸。所需的片外输入匹配允许灵活地根据系统特定要求优化器件性能。双元件匹配（请参阅图 6-2）足以支持单个 GNSS 频段操作。四元件匹配（请参阅图 6-3）允许多频段匹配以优化 NF、GAIN 和 S11 的性能。

6 引脚 WSON-FCRLF 封装具有可湿性侧面，允许通过自动光学检测 (AOI) 目视检查焊点，从而提高产品可靠性，而不会增加昂贵的 X 射线检测系统的制造成本。TRF3302 引脚排列（请参阅图 4-1）通过在 RFIN 引脚周围布置射频接地引脚（VCC 和 GND）以及在 RFOUT 引脚周围布置 EN 和 GND 来针对 PCB 布局 and 射频性能进行了优化。

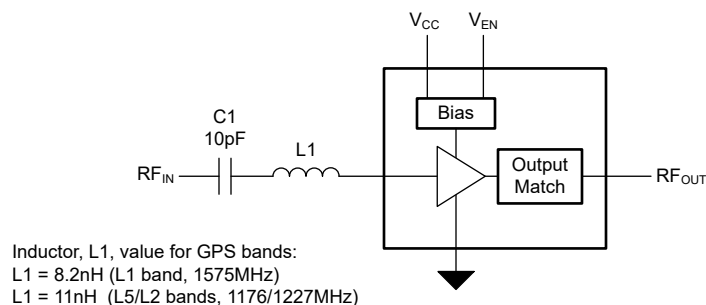


图 6-2. TRF3302 典型单 GNSS 频段配置

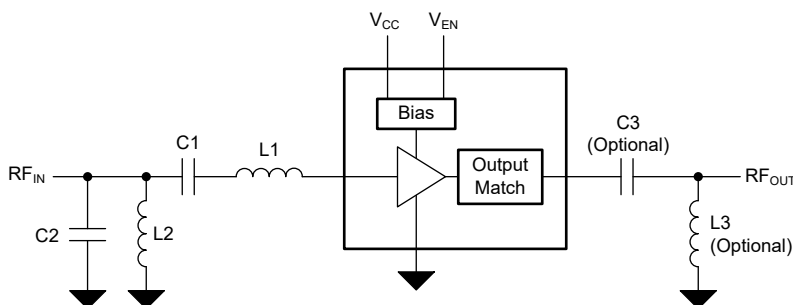


图 6-3. TRF3302 典型多 GNSS 频段配置

6.4 器件功能模式

TRF3302 具有 EN 引脚，必须将该引脚强制为高电平（逻辑 1）才能启用器件。要将器件断电，请将 EN 引脚连接到接地电位（逻辑 0）。EN 引脚不能悬空，并且必须强制施加电压才能使器件正常运行。

7 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

7.1 应用信息

TRF3302 是一款单端输入及输出 LNA。该器件通常用于 GNSS 全球定位系统，以提高 GNSS 接收器的灵敏度。这一改进是由于该器件的 0.8dB NF 与用于上或下 L 频段 GNSS 系统的 $\approx 17\text{dB}$ 增益相结合而实现的。在接收天线远离 GNSS 接收器并通过电缆或长迹线连接的系统中，TRF3302 通过在信号到达 GNSS 接收器之前放大信号，同时增加超小的放大器噪声，来帮助提高对噪声拾取的信号抗扰度。对于需要同时支持较高和较低 L 频段的系统，TRF3302 将使用宽带输入匹配网络（请参阅节 7.2.1）。

7.2 典型应用

7.2.1 多频段配置的 TRF3302

图 7-1 显示了 TRF3302 在多频段配置中的典型应用，同时涵盖驱动 AFE 的上下 GNSS L 频段。

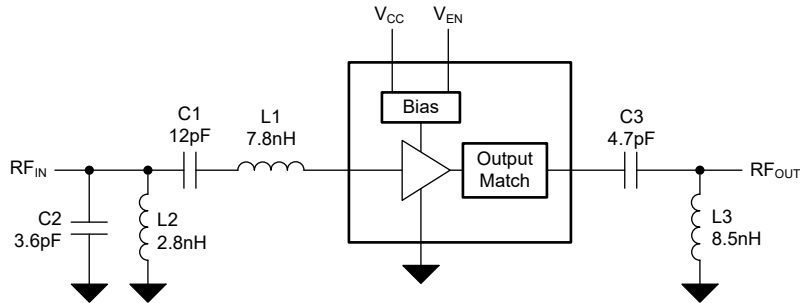


图 7-1. 配置中的 TRF3302 涵盖 L1、L2 和 L5 GPS 频段

7.2.1.1 设计要求

多频段接收应用的主要设计要求是将 NF、GAIN 和 S11 优化至相关频率范围。为图 6-3 选择输入匹配网络，以支持 1165MHz 至 $\approx 1630\text{MHz}$ 的频率范围，覆盖所有主要的 GNSS L 波段。TRF3302 的 S22 本身就具有宽带特性，并且在 1200MHz 范围内甚至超过 1630MHz 范围内小于 -10dB 。选择可选的输出匹配，使输出回波损耗 (S22) 在从 1165MHz 到 1630MHz 的整个相关频率范围内小于 -10dB 。

7.2.1.2 详细设计过程

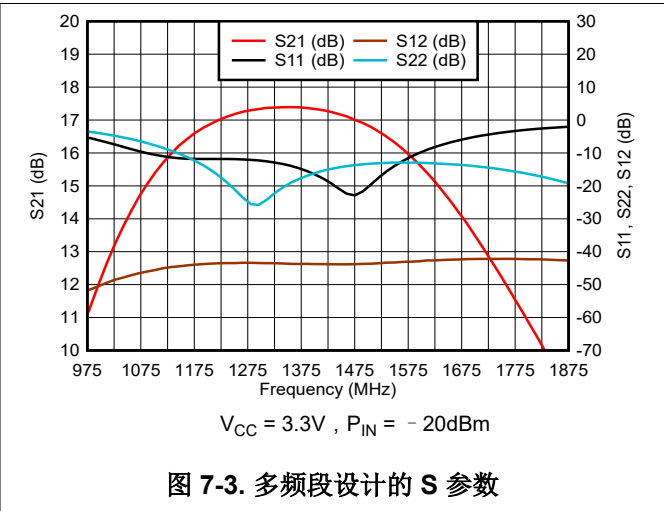
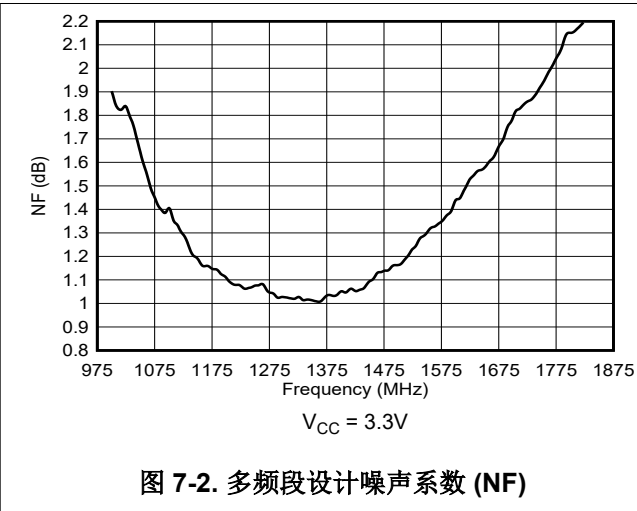
表 7-1 示出了为设计要求选择的匹配网络元件。TRF3302 的 S 参数用于获得针对增益、S11 和 S22 响应进行优化的元件值，并使用 TRF3302 EVM 在工作台上进行验证。

表 7-1. 匹配网络元件值

元件	元件值	器件型号
电感器, L1	7.8nH	0402DC-7N8
电容器, C1	12pF	GJM1555C1H120JB01
电感器, L2	2.8nH	0402DC-2N8
电容器, C2	3.6pF	GJM1555C1H3R6BB01
电感器, L3	8.5nH	0402DC-8N5
电容器, C3	4.7pF	GJM1555C1H4R7BB01

7.2.1.3 应用曲线

图 7-2 和图 7-3 分别显示了多频段设计的 NF 及 s 参数响应。



7.3 电源相关建议

TRF3302 由 1.8V 至 3.3V 单电源供电。通过靠近器件放置的去耦电容器来隔离电源电压。选择自谐振频率大于应用频率的电容器。当并联多个电容器来形成宽带去耦网络时，请将具有较高自谐振频率的电容器放置在更靠近器件的位置。

7.4 布局

7.4.1 布局指南

图 7-4 显示了 TRF3302 的良好布局示例。仅示出顶部信号层。使用具有高增益的相对宽带射频 LNA 进行设计时，请采取一定的电路板布局布线预防措施，以保持稳定性和优化的性能。使用多层板来保持信号完整性和电源完整性。

- 将所有输入和输出匹配元件尽可能靠近射频引脚放置，尤其是高 Q 输入匹配电感器。
- 将射频输入和输出信号布线为接地共面波导 (GCPW) 布线。
- 确保顶部的接地平面和任何内部层均用过孔缝合良好，并且 PCB 的第二层具有连续的接地层，LNA 附近没有任何开孔。
- 避免在射频信号线路附近对时钟及数字控制线路进行布线。
- 请勿将射频或者直流信号线布置在有噪声的电源平面上。
- 将电源去耦盖放在器件附近。

有关电路板布局 and 设计的更多详细信息，请参阅 [TRF3302 评估模块用户指南](#)。

7.4.2 布局示例

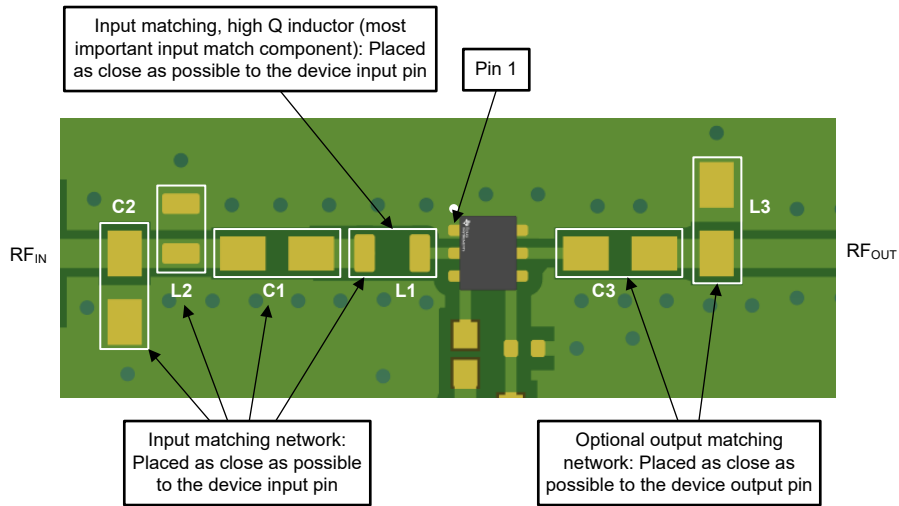


图 7-4. 布局示例

8 器件和文档支持

8.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](https://www.ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

8.2 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

8.3 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

8.4 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

8.5 术语表

TI 术语表 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

9 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

日期	修订版本	注释
October 2025	*	仅草稿

10 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TRF3302VBLR	Active	Production	WSO-FCRLF (VBL) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 105	P30

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TRF3302 :

- Automotive : [TRF3302-Q1](#)

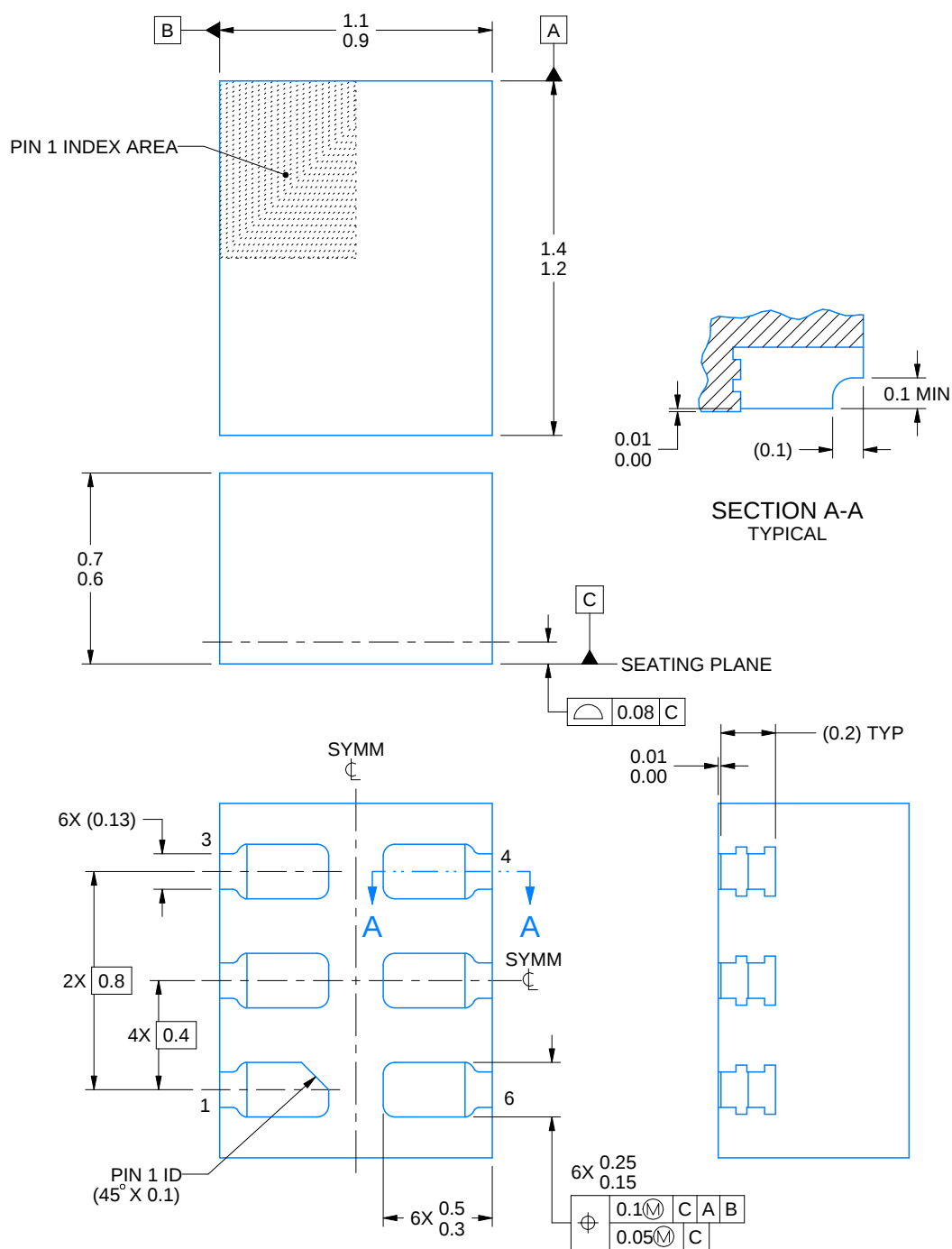
NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects



WSN-FCRLF - 0.7 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



4230092/B 01/2025

NOTES:

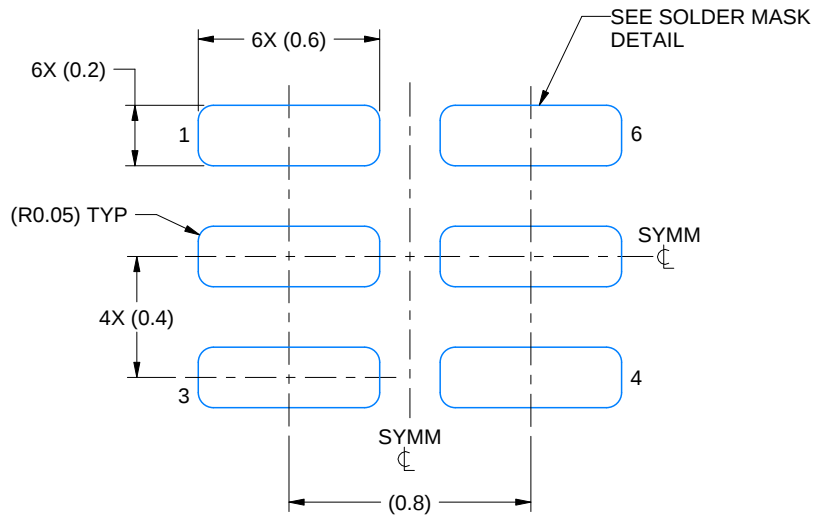
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

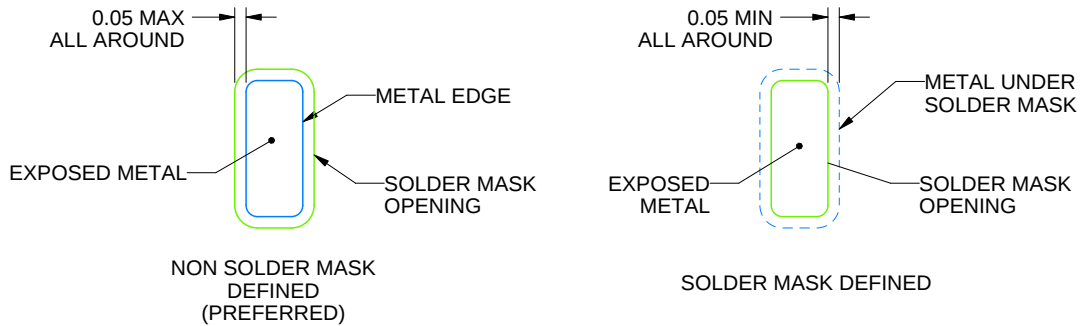
VBL0006A

WSON-FCRLF - 0.7 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 40X



SOLDER MASK DETAILS

4230092/B 01/2025

NOTES: (continued)

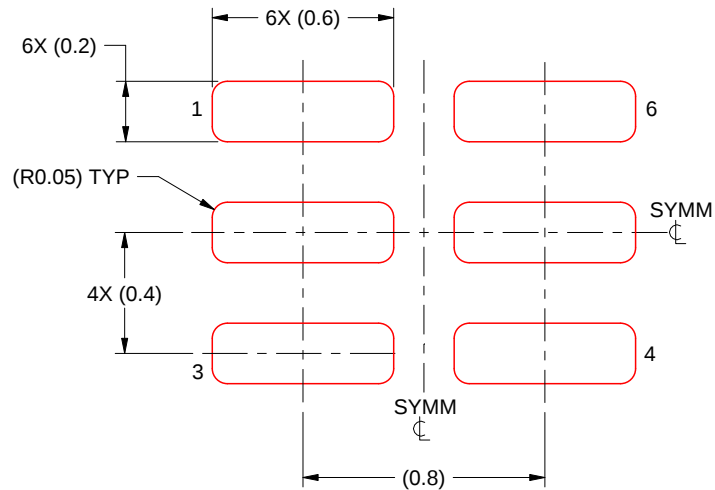
3. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

VBL0006A

WSO-FCRLF - 0.7 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.1 MM THICK STENCIL
SCALE: 40X

4230092/B 01/2025

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月